



**UNIwersYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO
w WARSZAWIE**

Dział Techniczny

ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa, tel. (48 22) 561 88 58, fax (48 22) 561 90 21
ul. Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa,

FORMULARZ

DO ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT nr 9/DT/2017

Na usługę wykonania programu funkcjonalno-użytkowego dla projektu polegającego termomodernizacji budynku nr 12, na terenie kampusu UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 w Warszawie.

Nazwa i adres WYKONAWCY

Odpowiadając na Zaprośzenie do składania ofert

1. Oferuję/emy wykonanie **I ETAPU** przedmiotu zamówienia na niżej przedstawionych warunkach:

| Oferowana usługa | szt. | Całkowita wartość netto | Stawka VAT | Całkowita wartość brutto |
|--|------|-------------------------|------------|--------------------------|
| Program funkcjonalno-użytkowy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. Opis przedmiotu zamówienia zgodnie z ustawą PZP i aktami wykonawczymi do postępowania na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej. Szacowanie wartości zamówienia (suma planowanego kosztu prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych). Mapa do celów projektowych/zasadnicza. | | |% | |
| RAZEM: | | | X | |

1.2. Oferowany termin wykonania usługi:



UNIwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Dział Techniczny

ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa, tel. (48 22) 561 88 58, fax (48 22) 561 90 21
ul. Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa,

2. Oświadczam/my, że zapoznałem/liśmy się z postanowieniami umowy i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru mojej/naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Zapytaniu Ofertowym, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

3. Wszelką korespondencję w sprawie zapytania ofertowego należy kierować na adres:

Tel. _____ Fax. _____ e-mail _____

4. Ofertę składam / y na kolejno ponumerowanych stronach.

.....

Podpis i pieczęć